

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 4 区分
【発行日】平成20年2月28日 (2008.2.28)

【公開番号】特開2005-205914(P2005-205914A)
【公開日】平成17年8月4日 (2005.8.4)
【年通号数】公開・登録公報2005-030
【出願番号】特願2005-13145(P2005-13145)
【国際特許分類】

B 2 9 C 51/38 (2006.01)

G 1 1 B 5/84 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 51/38

G 1 1 B 5/84 Z

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月15日 (2008.1.15)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

基板の上に配置されたエンボス可能フィルムをほぼエンボッシング温度に予備加熱するためのヒータと、

前記エンボス可能フィルムにインプリントするためのエンボッシング箔を有するダイ組立体と、

前記ヒータと前記ダイ組立体の間に配置され、前記ほぼエンボッシング温度を維持する加熱トンネルと

から構成されることを特徴とする恒熱インプリント・インボッシング組立体。

【請求項 2】

基板の上に配置されたエンボス可能フィルムほぼエンボッシング温度に予備加熱するステップと、

加熱トンネルを通じて前記基板をエンボス可能フィルムにインプリントするためのダイ組立体に搬送するステップとから構成され、

前記加熱トンネルが前記エンボッシング温度を維持することを特徴とする恒熱インプリント・インボッシング方法。

【請求項 3】

基板の上に配置されたエンボス可能フィルムをほぼエンボッシング温度に予備加熱する手段と、

前記ほぼエンボッシング温度を維持しながら、前記基板をインプリンティング・ダイ組立体に搬送する手段とを備えることを特徴とする恒熱インプリント・インボッシング組立体。